



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Chips Joint Undertaking

Struktura

Podjmowanie decyzji

Przygotowanie konkursów



12.02.2024 r.



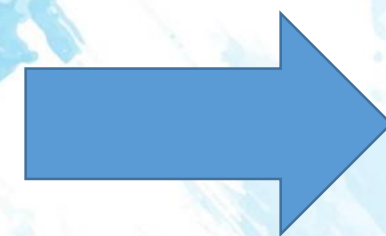
HORIZON EUROPE

SINGLE BASIC ACT



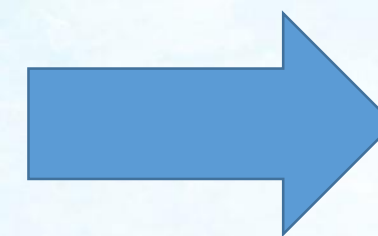
ECSEL
Joint Undertaking

2014 - 2021



KDT JU
KEY DIGITAL
TECHNOLOGIES
JOINT UNDERTAKING

2021 - 2023



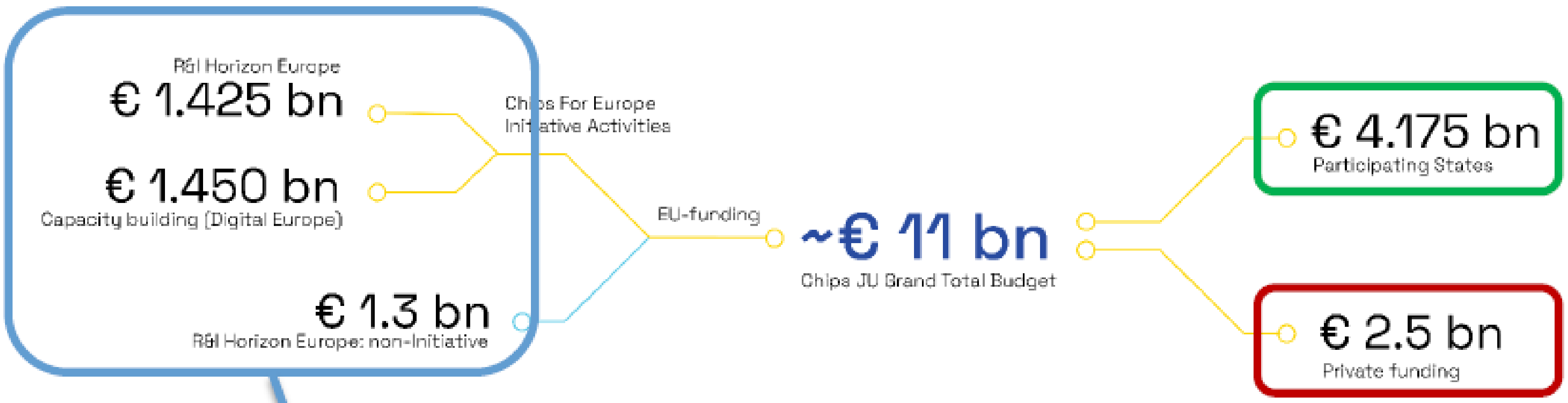
Chips^{*}JU**

2023+

Podstawowe informacje

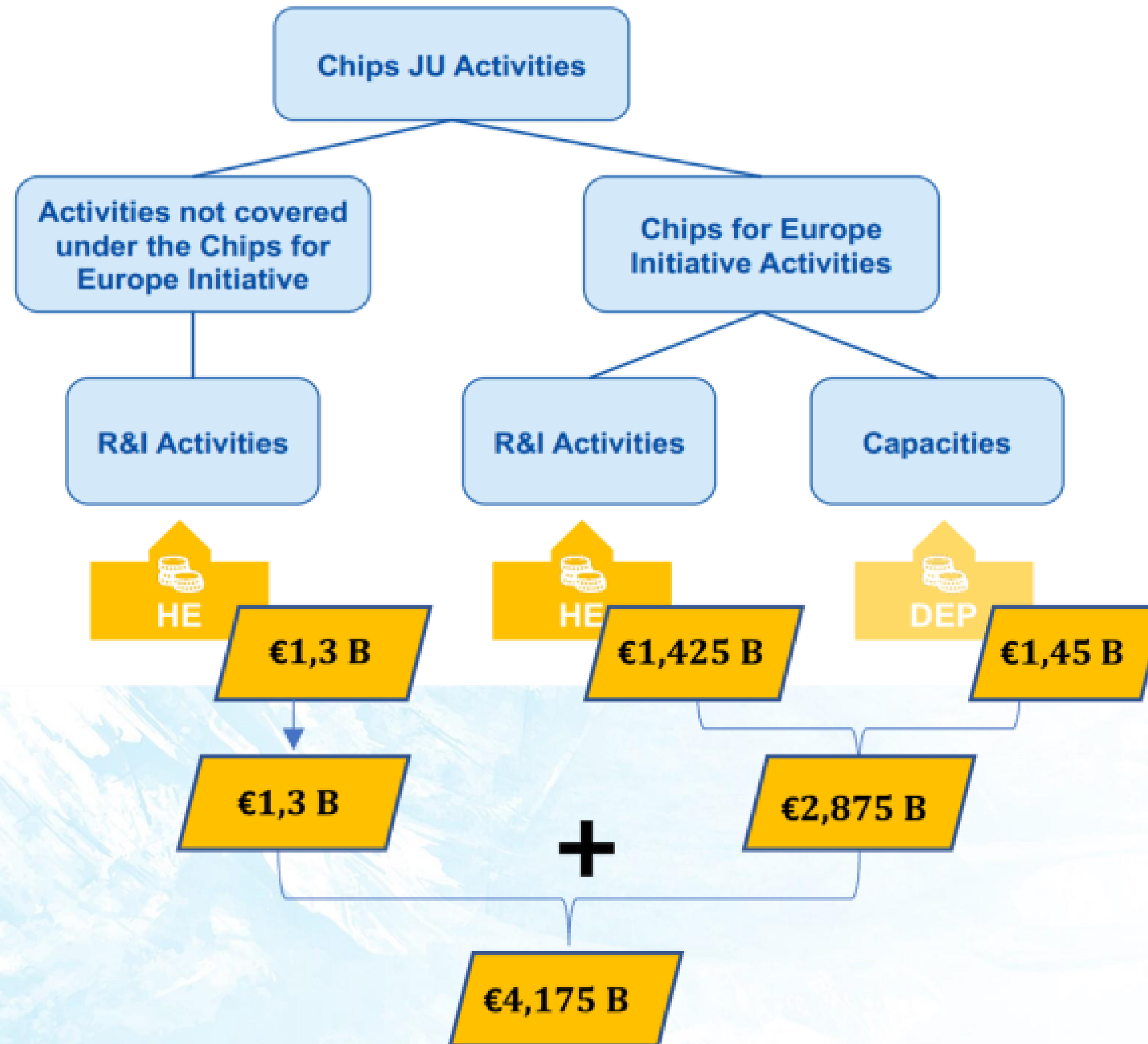


| | |
|------------------------------------|---|
| Podstawa prawna: | Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” |
| Rodzaj partnerstwa: | Partnerstwo zinstytucjonalizowane (Art 187 TFEU) – joint undertaking |
| Podmiot koordynujący: | Private members are represented by the AENEAS and INSIDE Associations. The Participating States and the Commission are represented by the Public Authorities Board |
| Szacunkowy budżet: | ~11 mld EUR |
| Wkład UE: | 4,175 mld EUR |
| Wkład państw członkowskich: | „commensurate amount” (współmierna kwota) |
| Wkład partnerów prywatnych: | 2.5 mln EUR |



| EU Contribution to Chips JU (excl | Chips for Europe Initiative | Non-Initiative | Total |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| R&I (Horizon Europe) | 1.425 | 1.300 | 2.725 |
| Cap building (DEP) | 1.450 | n.a. | 1.450 |
| Total | 2.875 | 1.300 | 4.175 |

EU Funding 2023-2027



Three pillars of the Chips Act

European Semiconductor Board (Governance)

Pillar 1

Chips for Europe Initiative

- Initiative on infrastructure building in synergy with the EU's research programmes
- Support to start-ups and SMEs

Pillar 2

Security of Supply

- First-of-a-kind semiconductor production facilities

Pillar 3

Monitoring and Crisis Response

- Monitoring and alerting
- Crisis coordination mechanism with MS
- Strong Commission powers in times of crisis

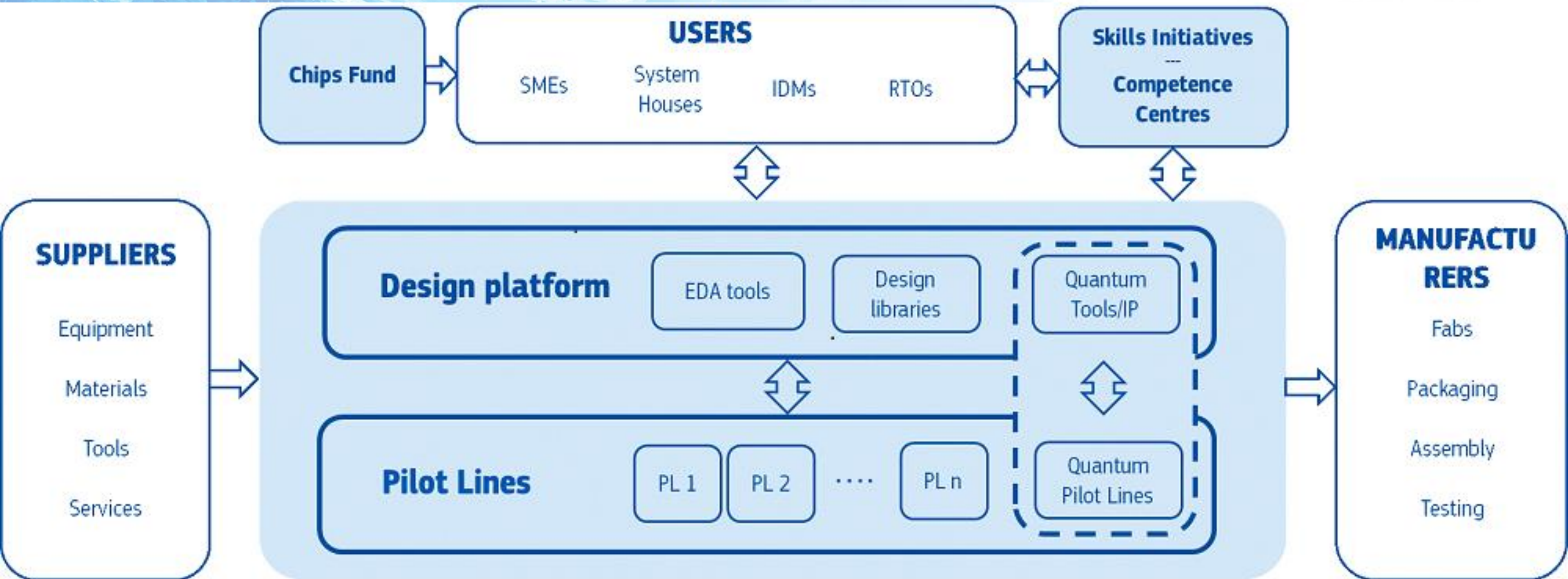
Główne cele KDT JU:

- Wzmacnianie strategicznej autonomii UE obszarze komponentów i systemów elektronicznych.
- Ustanowienie wiodącej pozycji UE w zakresie doskonałości naukowej i innowacji.
- Zapewnienie, że technologie komponentów i systemów odpowiadają na wyzwania społeczne i środowiskowe Europy.

Nowości w Chips JU:

- Linie pilotażowe
- Centra Kompetencji
- Design Platform
- Quantum Chips technology
- **Zwiększony budżet UE z 1,8 do 4,175 mld EUR**

Chips for Europe Initiative



Non- INITIATIVE CALLS

W 2024 r. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz chipów ogłosi trzy konkursy (calls):

- **KONKURS (1):** wnioski na działania innowacyjne (o wyższym poziomie TRL), obejmujące temat globalny i 2 tematy szczegółowe (FOCUS TOPICS), zostanie przeprowadzone w dwóch etapach.
- **KONKURS (2):** Na wnioski dotyczące działań w zakresie badań i innowacji (niższe poziomy TRL), obejmujące temat globalny i realizowane w 2 etapach.
- **KONKURS (3):** 1 temat dotyczący działań w zakresie badań i innowacji (RIA), który zostanie wdrożony jako jednoetapowe zaproszenie bez wkładu krajowego, we współpracy z Koreą Południową (ROK).

Cześć związana z CHIPS FOR EUROPE INITIATIVE

Objective 1: Build large-scale design innovative capacities for integrated semiconductor technologies

Objective 2: Enhance existing and developing new pilot lines

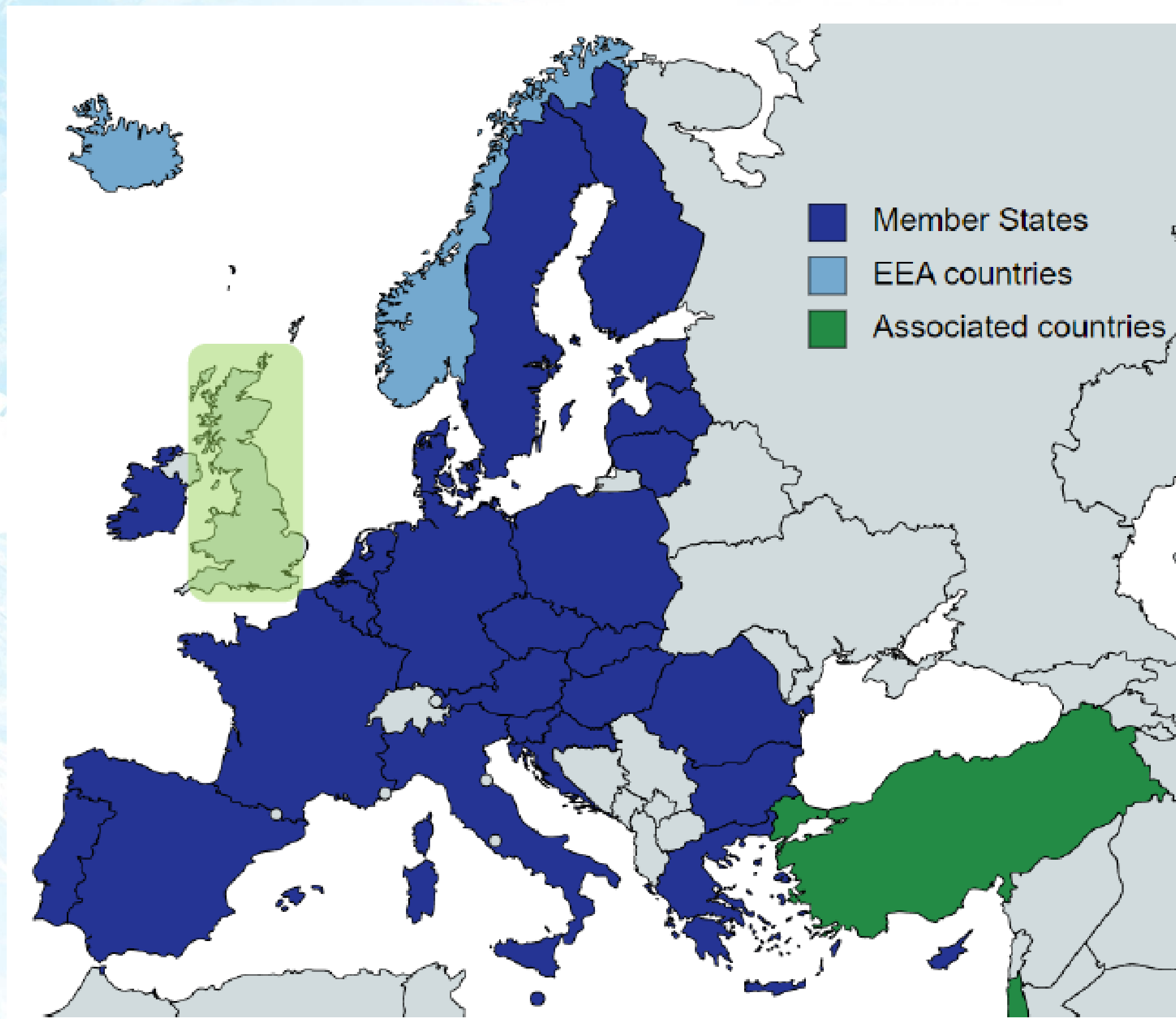
Objective 3: Build advanced technology and engineering capacities for accelerating the development of quantum chips

Objective 4: Create a network of competence centres across Europe

1-4 realizowane w ramach WP Chips JU

Objective 5: Establish a Chips Fund to facilitate access to debt financing and equity by start-ups, scale-ups and SMEs and small mid-caps in the semiconductor value chains (realizowany w ramach InvestEU oraz EIC)

CZŁONKOWIE



ZARZĄDZANIE

GOVERNING BOARD

kwestie strategiczne i kierunki działania

EXECUTIVE DIRECTOR

Codzienne zarządzanie

PUBLIC AUTHORITIES BOARD

konkursy o dofinansowanie

PRIVATE MEMBERS BOARD

**Strategic Research and Innovation
Agenda**

REPREZENTACJA POLSKI W CHIPS JU

GOVERNING BOARD

Marcin Michałowski (MNiSW) – gł. delegat – marcin.michalowski@mnisw.gov.pl

Małgorzata Szolucha (NCBR) – zastępca – malgorzata.szolucha@ncbr.gov.pl

Andrzej Jarzewski (MRiT) – zastępca – andrzej.jarzewski@mrit.gov.pl

Agata Wancio (MRiT) – zastępca – agata.wancio@mrit.gov.pl

Paulina Nowak (NCBR) – finansowanie wkładów krajowych, paulina.nowak@ncbr.gov.pl

Jerzy Kątcki (Łukasiewicz-IMI) – ekspert

PUBLIC AUTHORITIES BOARD

Marcin Michałowski (MNiSW) – główny delegat

Andrzej Jarzewski (MRiT) – zastępca

Agata Wańcio (MRiT) – zastępca

Małgorzata Szolucha (NCBR) – zastępca

Paulina Nowak (NCBR) – finansowanie wkładów krajowych

POLSCY CZŁONKOWIE STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH

STOWARZYSZENIE AENEAS

Dr hab. inż. Łukasz Kulas – Politechnika Gdańska

Dr inż. Dariusz Szmigiel, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

STOWARZYSZENIE EPoSS

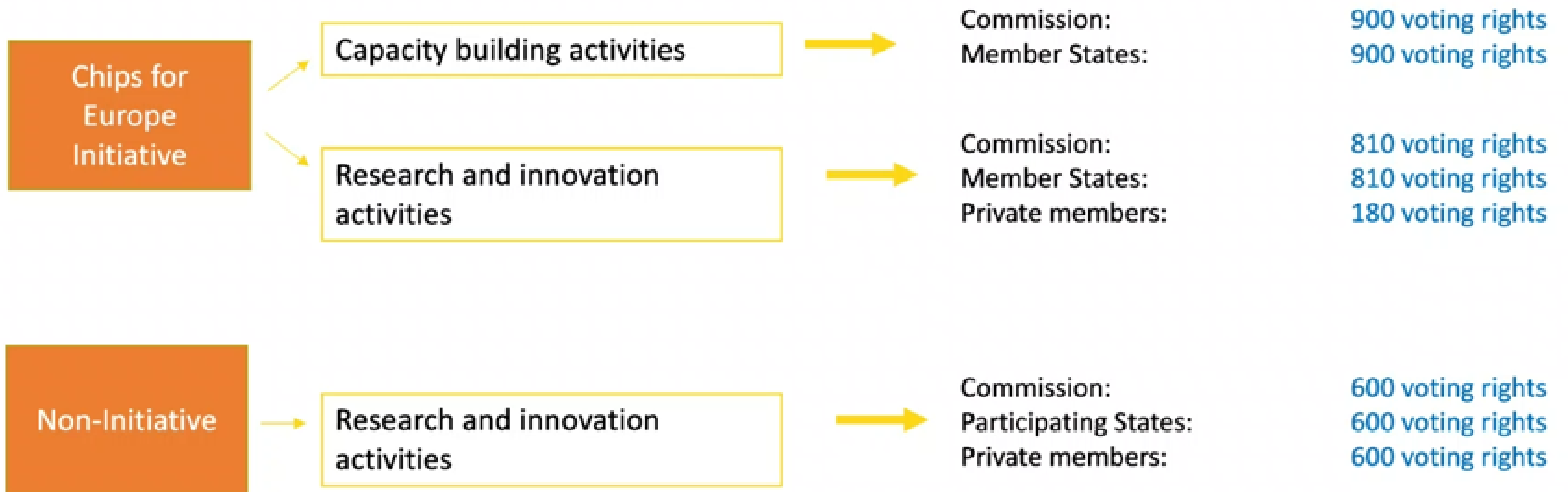
Dr inż. Tomasz Bieniek, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Dr inż. Grzegorz Janczyk, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

STOWARZYSZENIE INSIDE

Dr hab. inż. Łukasz Kulas – Politechnika Gdańska

PODEJMOWANIE DECYZYJI



PRZYGOTOWANIE KONKURSÓW

Strategiczna Agenda Badań i Innowacji dla Komponentów i Systemów Elektronicznych (ECS-SRIA)

- ✓ Przygotowywana każdego roku, przez ponad ponad 300 ekspertów ze społeczności ECS
- ✓ Koordynowana przez trzy stowarzyszenia branżowe: **AENEAS, EPoSS i Inside.**
- ✓ Jest to otwarty, żywy i niezależny od programów finansowania dokument, przedstawiający cele branżowe, korzyści społeczne i strategiczne korzyści dla Europy na najbliższe 10-15 lat.
- ✓ Prezentowana na GB i przyjmowana także przez GB.



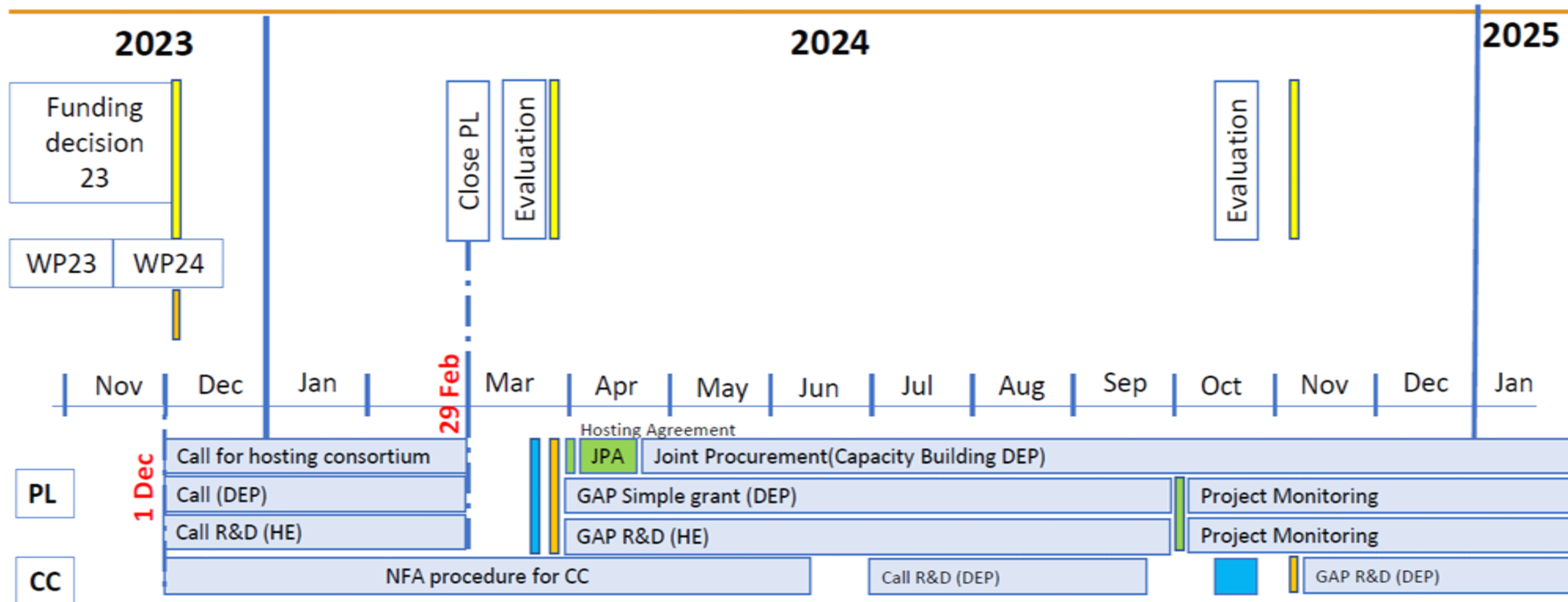
ECS SRIA 2024 Draft
Published November 2023

PRZYGOTOWANIE KONKURSÓW



PRZYGOTOWANIE KONKURSÓW

PLANNING CALLS 2024

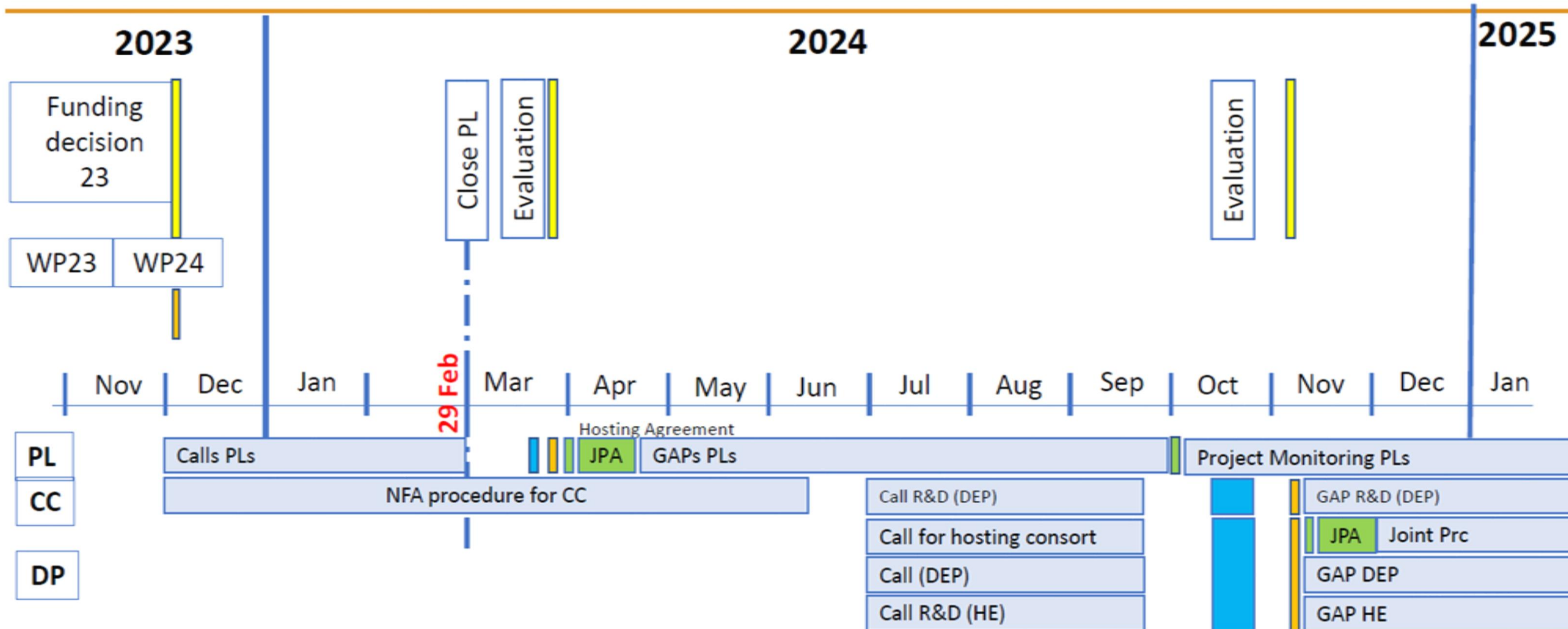


EUROPEAN PARTNERSHIP



PRZYGOTOWANIE KONKURSÓW

PLANNING CALLS 2024





Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Dziękuję

Marcin Michałowski

Departament Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marcin.michalowski@mein.gov.pl